ELECTRICALLY CONDUCTIVE PAINT

Patent number:

JP58103565

Publication date:

1983-06-20

Inventor:

ï

OGAWA YASUHIRO; SHINODA SANKICHI;

TAKESHIMA AKIYOSHI

Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

Classification:

- international:

C09D5/24

- european:

Application number: JP19810202208 19811214 Priority number(s): JP19810202208 19811214

Report a data error here

Abstract of JP58103565

PURPOSE:To provide an electrically conductive paint which consists of Ag-Be-Cu type conductive powder, resin and solvent and is low cost and excellent in electrical conductivity and migration characteristics. CONSTITUTION:Powdered alloy with a particle diameter of 0.05-10mu, consisting of 10-70wt% Ag, 0.1-3wt% Be and balance Cu, is dipped in an organic solvent solution of 1,2,3-benzotriazole. Upon separation of the solvent and drying, electrically conductive powder surface coated with a thin film of a chelate compd. is obtained. Then the conductive powder, a thermosetting resin (e.g. xylene resin) and a solvent (e.g. ethyl carbitol) are kneaded to produce an electrically conductive paint. The paint is applied to phenolic resin substrate, etc. by screen printing, etc. and is cured in the air under heating to form electrode and conducting path.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

^⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭58—103565

DInt. Cl.3 C 09 D 5/24 識別記号

庁内整理番号 6516-4 J

砂公開 昭和58年(1983)6月20日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

20特

願 昭56-202208

22出

願 昭56(1981)12月14日

⑫発 明 者 小川泰弘

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

⑫発 明 者 信太三吉

門真市大字門真1006番地松下電 器産業株式会社内

⑫発 明 者 竹島明美

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

⑪出 願 人 松下電器産業株式会社

門真市大字門真1006番地

個代 理 人 弁理士 中尾敏男

外1名

1、発明の名称

導電性ペイント

2、特許請求の範囲

- (1) 導電粉、樹脂および溶剤からなり、導電粉が 少なくとも A9 10~ 7 0 重量 5 と BeO.1 ~ 3 重量 あを含有し、残部が Cu の組成からなる合金粉であ ることを特徴とする導電性ペイント。
- (2) 合金粉が、1,2,3-ペンゾトリアゾール を有機溶媒に溶かした溶液に浸渍後、前記溶液と 分離し、乾燥させたものであることを特徴とする 特許請求の範囲第(1)項記載の導電性ペイント。

3、発明の詳細な説明

本発明は導電性ペイントに関し、安価で導電性 にすぐれ、しかも耐マイグレーション性にすぐれ た導電性ペイントの提供を目的とするものである。 従来、この種の導電性ペイントには、導電粉と してAu , A9 , Pd などの貴金属粉が用いられて きた。一般的には、導電粉にAS を用い、フェノ - ル樹脂、エポキシ樹脂、キシレン樹脂などの熱

硬化型樹脂とエチルカルピトールのような溶剤と 共に混練したAタペイントを、フェノール樹脂基板 などにスクリーン印刷等の方法で塗布した後、加 熱硬化し、可変抵抗器などの電極、あるいは電子 回路用の位刷配線導体として使用されてきた。

しかし、近年電子機器の小型化や薄型化に伴な い電子部品の小型化が強く要望される傾向にあり、 とのような状況下では、Aダペイントの使用が、Aダ ペイント硬化膜中のA9が大気中の湿気と直流電界 との相互作用により、Aダペイント電極相互間を移 行する現象、いわゆるマイグレーションを起こし、 その結果回路の短絡を起とし、しばしばトラブル の大きな要因となっている。

とのようた Agペイントの欠点を補うために、Ag - Pd 粉を用いた導電性ペイントが市販されている が、まだ完全とはいえない。また、A9-Pd粉を 用いた導電性ペイントは、Pdの価格がASの価格 に較べて極めて高く、さらに、貴金属類特に A9 の価格高騰が激しい近年の情勢では、経済性の点 で極めて不利である。

以上のような理由から、耐マイグレーション性 の良い安価な導電性ペイントの出現が望まれている。

本発明はこのような点に鑑みて成されたものであり、発明者らは、卑金属を主成分とする合金紛を調査検討した結果、A9-Be-Cu合金粉を導電粉とした導電性ペイントが、耐マイグレーション性にすぐれ、しかも導電性をかなりのレベルで満足することを見い出した。

次に、本発明の構成を詳述する。

本発明にかかる導電性ペイントは、その導電粉が少なくともA910~70重量をとBeO.1~3 重量を含有し、残部がCuという組成のA9-Be-Cu合金粉であるととを特徴とする導電性ペイントである。

この種の樹脂硬化型の導電性ペイントの導電粉 において望まれる条件は、

a、導電性があること

b、加熱硬化時における耐熱酸化性があることがあげられる。

る。また、合金元素としてのBeの添加は、A9-Cu合金粉の耐熱酸化性をも改善する傾向にある。これは、Be酸化物が合金粉の過度の酸化を防止しているものと推察される。さらに、Be自身の耐環境性によっても、その添加により耐食性の効果を呈するものと考えられる。しかしながら、Beの添加量が適量を越えると、合金粉自体の導電性が降下すること、機械的加工能が低下し、微粉化が困難なことなどにより望ましい特性は得られない。

A9 - Be - Cu合金粉が導電性ペイントの導電粉として、上述の長所を見い出し得る合金組成は、A910~70重量券、Be O.1~3重量券、残部Cuである。A9の下限は合金粉の耐熱酸化性から、上限は経済性からそれぞれ制約される量である。また、Be量の下限はその添加効果を見い出し得る成少量、上限は合金粉の作製上から制約される量である。

以上のように、A9-Be-Cu合金粉を用いた導電性ペイントは、導電性がマイグレーション性の面で実用上十分な性能を見い出し得るものである。

金属であるが、耐熱酸化性、耐食性は良いとは言えない。したがって、ペイント硬化処理における加熱によって、しばしば Cu 粉の表面に多量の酸化スケールが発生し、ペイント硬化膜の十分な導電性が得られない。このような Cu 粉の欠点は、合金元素として Ag を添加することにより改善される。しかしながら、耐マイグレーション性において、Cu がマイグレーションを起こしにくいということから、 Ag - Cu 合金粉は Ag 粉に較べると改善される傾向にあるが、十分な耐マイグレーション性は得られない。このような Ag - Cu 合金粉の難点は、

合金粉の一成分である Cuは、導電性にすぐれた

イグレーション性の改良をもたらすかは明確では ないが、 Be 自身がマイグレーションを起こしにく いということと、 Be が Ag に較べて極めて卑な金

さらに Beを合金元素として添加することにより大

幅に改良される。合金化が何故にとのようを耐っ

ベイントとして使用された場合のすぐれた耐マイ グレーション性をひき出しているものと推察され

属であるということが A9-Be-Cu合金粉が導電性

しかしながら、一般的に Cu まよび Cu 系合金の耐食性は過度の腐食環境においては必ずしも良好ではないように、本発明における合金粉においても、そのような雰囲気に放置された場合、耐食性は必ずしも満足できるものではない。しかして、ひずした後、合金粉に1,2,3-ペンントリアゾールをでした後、溶液を分離して乾燥させるという処理(以下、ペンソトリアゾール処理と呼ぶ)により解決される。推察するに、上配のペンゾトリアゾール処理によって合金粉表面に薄いキレート化合物の皮膜を形成することにより、防食効果を発揮しているものと思われる。

本発明に従えば、A9-Be-Cu合金粉、あるいは、ペンゾトリアゾール処理を行なったA9-Be-Cu合金粉を、熱硬化型の樹脂と溶剤と共に混練して導電性ペイントとなす。この導電性ペイントは、通常のA9ペイントと同様にフェノール樹脂基板等にスクリーン印刷等の方法で塗布した後、大気中で加熱硬化して、電極や導電路として利用さ

れる。合金粉の粒径は 0.05~1 0 μ の範囲、好ましくは 0.5~5 μ程度が良い。10 μ以上になるとスクリーン印刷時の印刷性が悪化し、最終加熱硬化後の面抵抗が大きくなる。

D

次に、本発明をより具体化するために実施例に ついて詳述する。

本発明に従うA9-Be-Cu合金粉は、次のようにして作製した。本発明に従う合金組成に合わせて、A9-Be-Cuの各案材を秤量し、全量を15をとした(BeはCu-Be-母合金により添加した)。これを望素ガス中で溶解し、さらに、溶弱噴霧法によって粉体化した。噴霧群として窒素ガスを利用し、水中投入冷却した。得られた合金粉の粒径は5~100μ程度のものであるが、これを機械式粉砕機にて再度粉体化し、平均粒径約2μとした。

上記の方法によって得られた合金粉の一部については、ペンントリアソール処理を行なった。ペンソトリアソール処理は次の手順で行なった。1,2,3ーペンソトリアソール10 写をアセトン100ml中に容解させ、この容液に合金粉109を浸渍し十

分に分散させた。この後、合金粉と溶液を分離し、 合金粉を乾燥した。

以上の方法によって得られた合金粉29、あるいはペンゾトリアゾール処理を行なった合金粉29を、キンレン樹脂19、エチルカルビトールO.29と共に、フーバーマーラを用いて混練した。フーバーマーラによる混練は、荷重100ポンド、40回転を4回繰り返して行なった。

上記作製した導電性ペイントをスクリーン印刷 法を用いてフェノール樹脂基板上に所定の形状に 印刷後、大気中190℃10分間の条件で加熱硬化 した。

上記印刷パターンの両端間の抵抗値を測定した結果と、さらに40℃95%RHの恒温恒湿槽に120時間放置した後で測定した結果を次表に示す。表には、市販のA9紛、Cu粉を導電粉とした場合の結果を併ぜて示す。

(以下余白)

-					
	導 電粉合金組成 (重量多)	ベントリ	面抵抗	(n∕□)	備考
		アゾール 処理の有 無	加熱硬化後	恒温恒湿槽に 放置後	
	10 Ag-0.5 Be-残Cu	無	1 ~ 4	2 ~ 7	本発明
		有	1.5 ~ 4	2 ~ 6	,
	50Ag~3Be~残Cu	無	0.2~0.75	0.3 ~ 0.85	,
	30Ag-0.1Be-残Cu	無	0.5 ~ 0.6	0.5 ~ 1	•
		有	0.35~0.6	0.4 ~0.8	,
	70Ag-1Be-残Cu	無	0.07~0.2	0.1 ~ 0.2 5	,
	Cu	無	10 ~ 50	∞-	谷 考
		有	25 ~ 80	510~680	,
	Ag	無	0.005~0.05	0.005~0.05	•

また、耐マイクレーション性の試験として、上に、間になるイントを、フェノール樹脂基板 して、上に、間隙 O.5 mmのパターンをスクリーン印刷し、加熱硬化させた後、間隙部に純水 O.2 m ℓ を滴下した状態で、間隙間に直流 3 V の電圧を印加し、間隙に流れる電流を測定したところ、電圧印加度であったところ、電圧印加度であった。これに対し、A9 粉を導電粉としたペイントに対したのは酸を行なったところ、電圧の加接のは酸を行なったところ、電圧の加接 1 分間経過時点で間隙部でA9の移行が観察される短路を起こした。したがって、本発明にかかる導電性ペイントは、従来のA9ペイントに較べて、計算マイクレーション性が極めてすぐれていると言える。

上記した説明および表から明らかなように、本 発明にかかる導電性ペイントは、従来のAタペイン トに比較して、導電性、耐食性の面で多少劣る面 があるものの、十分実用に供し得る特性を示すも のであり、特に耐マイグレーション性にすぐれて おり、経済的には従来のAタペイントに較べて極め て安価に作製し得るととから、その工業的価値は 大なるものがある。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名